

EN 158B2 底部填充封装材料 產品資料表

卓越的熱循環性能
優異的機械衝擊性能
高良率

簡介

EN 158B2 底部填充封装材料是一種結合毛細流動特性與封装功能的液態環氧材料，具有快速固化、流動性佳及易於返修等特點。可作為底部填充材料用於 Flip Chip、CSP、BGA、PoP 以及 LGA 等應用。同時，可為先進封装中的裸晶提供可靠保護，包括記憶卡封装、IC 載體封装、混合集成電路 (HIC) 以及多晶片模組 (MCM) 等應用。該材料專為高產量和環保生產環境而設計，尤其適用於對製程速度和機械衝擊性能有較高要求的應用。該材料易於點膠，可最大限度地減少應力，並提供卓越的可靠性性能 (例如溫度循環性能) 和出色的機械強度。跌落測試性能也提升了。

物理特性

产品名称	EN 158B2 底部填充封装材料
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	2.0 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	25-45k cp
玻璃化轉變溫度 (T _g) (ASTM D3418-82)	149 °C
固化后材料性能	
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 20; \alpha_2 = 136$
搭接剪切強度 (FR4/FR4)	2480 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过

推荐固化条件

在 150°C 溫度下加熱 35-45 分鐘。

注意:固化時間包括使黏合部位達到所需固化溫度所需的時間。可以評估其他固化方案。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下, 于原密封包装中储存, 保质期为 6 个月。超过该期限储存可能导致材料粘度升高。请防止材料受潮、挥发或混入异物, 否则可能对其加工性能产生不利影响。

安全说明

EN 158B2 为环保型、低毒性材料。在操作和使用过程中仍建议遵循常规工业卫生与安全规范。详细安全信息请参阅产品 安全数据表。

包装规格

EN 158B2 封裝膠系列提供 10 cc 和 30 cc 兩種規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息, 請聯繫 YINCAE 公司。